

## 2-1-2-39 SR 異物挟まり傷剥がれ／SR 夹杂杂物的剥离伤痕／ Spotty peeling of solder resist

【特徴】SR が小さく点状に剥離している状態の欠陥

【特征】在 SR 有 小点状剥落的缺陷。

【Characteristics】Solder resist is peeled in small spots

【原因・判断ポイント・発生工程】製品の積重ね時に、小さな異物が挟まった状態で搬送したことにより出来たもの（SR 塗布乾燥後）

【原因、判断要点、发生工序】在产品堆垛时夹着小杂物，一搬运就互相挤压所引起的（SR 烘干后）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】  
The defect is caused by carrying boards with a small foreign object sandwiched between stacked boards



【コメント】  
顕微鏡倍率 × 25

【注釋】  
显微镜倍率 × 25

【Comments】  
Magnification: ×25



【コメント】  
顕微鏡倍率 × 25

【注釋】  
显微镜倍率 × 25

【Comments】  
Magnification: ×25

## 2-1-2-40 SR 基底地インク汚れ／SR 基底の油墨玷污／ Ink-stained conductor under solder resist

【特徴】SR 基底地導体部にインクが付着している状態の欠陥

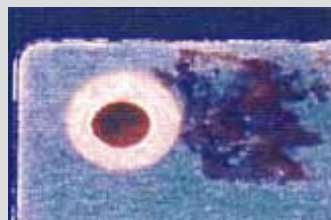
【特征】SR 基底的导线附着油墨的缺陷。

【Characteristics】Ink is attached on a conductor under solder resist

【原因・判断ポイント・発生工程】SR 印刷前研磨後に、何らかのインクを付着させたまま SR 印刷されたことにより出来たもの（SR 塗布工程）

【原因、判断要点、发生工序】在 SR 印刷前研磨后的板件附着某种油墨，未经处理就印刷 SR 所造成的（涂布 SR 工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】  
A kind of ink is attached to the conductor after the abrasion prior to solder resist application and then solder resist is applied. (Solder resist application)



【コメント】  
顕微鏡倍率 ×

【注釋】  
显微镜倍率 ×

【Comments】  
Magnification: ×



【コメント】  
顕微鏡倍率 ×

【注釋】  
显微镜倍率 ×

【Comments】  
Magnification: ×